

前次募集资金使用情况鉴证报告

锦州神工半导体股份有限公司

容诚专字[2026]110Z0219号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-7

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]110Z0219 号

锦州神工半导体股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的锦州神工半导体股份有限公司（以下简称神工股份）董事会编制的截至 2026 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供神工股份向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神工股份向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是神工股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对神工股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的神工股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大

方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了神工股份截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况。

（此页为锦州神工半导体股份有限公司容诚专字[2026]110Z0219号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

吴宇

中国注册会计师：_____

董博佳

中国·北京

中国注册会计师：_____

杜青松

2026年5月13日

锦州神工半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股10,305,736.00股，每股发行价格为人民币29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除各项发行费用合计人民币3,943,396.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]110Z0012号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023年9月，公司、国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）与招商银行锦州分行营业部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至2026年3月31日止，公司前次募集资金余额（含银行理财）为0.00元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	银行帐号	账户类别	初始存放金额 (元)	余额(元)
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	活期	210,000,000.00	已注销,零余额

银行名称	银行帐号	账户类别	初始存放金额 (元)	余额(元)
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	活期	86,999,974.96	已注销,零余额
合计			296,999,974.96	

注 1: 初始存放金额与实际募集资金净额差异 943,396.22 元, 系从募集资金专户中用于支付审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

注 2: 募投项目之“补充流动资金”对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理,公司于 2024 年 12 月将募集资金结余利息收入 0.14 万元补充到公司银行存款账户,同时注销公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行开立的募集资金专户(账户号: 0708004329200669624)。

注 3: 根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。为方便账户管理,公司于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户,同时注销公司在招商银行锦州分行营业部开立的募集资金专户(账户号: 416900037710703)。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日止, 本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况:

根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金 13,223.57 万元永久补充流动资金。

2023 年公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”时公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,经过充分论证制定的项目投资计划。

但随着半导体行业需求变化，外部环境较决策时已发生明显变化。全球和中国的市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化：一方面，由于全球半导体市场的结构性行情，导致市场整体景气度恢复的时间晚于公司最初预测，该业务的产能利用率未达预期；另一方面，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，改变了既有的全球产业格局，公司大直径硅材料的直接下游产品硅零部件受到国产化需求带动，实现连续大幅增长，成为公司第二增长曲线，对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求，需要资金投入。公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素，审慎决定不再继续投入原募投项目。“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”终止有利于合理利用募集资金，提高资金使用效率，不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司承诺募集资金投资金额、实际投资金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	20,905.66	8,257.64	-12,648.02
2	补充流动资金	9,000.00	8,700.00	21,971.68	13,271.68
合计		30,000.00	29,605.66	30,229.32	623.66

集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目募集后资金承诺投资金额 20,905.66 万元，截至 2026 年 3 月 31 日实际投资总额 8,257.64 万元，差异原因为公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素，审慎决定不再继续投入该募投项目，并将节余募集资金 13,223.57 万元永久性补充公司流动资金。

补充流动资金项目募集后资金承诺投资金额 8,700.00 万元，截至 2026 年 3 月 31 日实际投资总额 21,971.68 万元，差异原因为集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目节余募集资金 13,223.57 万元补充公司流动资金及购买理财产品产生的收益及利息收入投入项目所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,337,697.02 元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]110Z0157 号）。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 11,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投

资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况。

（六）前次募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 10 月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金 13,223.57 万元永久补充流动资金。

截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次向特定投资者发行股票募集资金已全部使用完毕，且专用账户已全部注销完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表

锦州神工半导体股份有限公司董事会



2026年5月13日



ThinkonSemi
半导体

锦州神州半导体股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

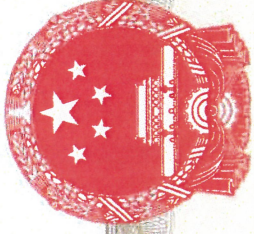
金额单位: 人民币万元

编制单位: 锦州神州半导体股份有限公司

募集资金总额: 29,605.66		已累计使用募集资金总额: 30,229.32							
变更用途的募集资金总额: 13,223.57		各年度使用募集资金总额:							
		2023 年: 2,582.84							
		2024 年: 9,765.69							
		2025 年: 4,556.15							
		2026 年 1-3 月: 13,324.64							
变更项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额		
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	20,905.66	8,257.64	20,905.66	-12,648.02	注	
2	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	8,700.00	21,971.68 (注)	8,700.00	21,971.68	13,271.68	不适用
	合计		30,000.00	29,605.66	30,229.32	29,605.66	30,229.32	623.66	

变更用途的募集资金总额比例: 44.67%

注: 根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止, 公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户。截至 2026 年 3 月 31 日, 募投项目已终止且募集资金已使用完毕并销户。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

经营范围

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2026 年 04 月 13 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制



姓名	吴宇
Full name	吴宇
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-03-01
Date of birth	1974-03-01
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	21010219740301153X
Identity card No.	21010219740301153X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021年8月7日

本证书经检验合格，继续
This certificate is valid for another
this renewal.



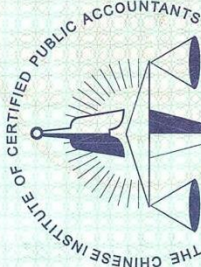
2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(3)
4月28日

2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
8月4日

证书编号: 210103050004
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年08月15日
Date of Issuance



中国注册会计师

姓名	董博佳
Sex	男
Date of birth	1988-07-01
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
身份证号码	210102198807011514



2020年度
年度检验登记合格
Annual Renewal Registration
合格
辽宁注协检(1)

8月4日
本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100324003
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年07月27日
Date of Issuance

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(3)
4月28日

辽宁注协检CPA
合格
2021年8月





姓名	杜青松
Sex	男
出生日期	1993-03-02
工作单位	密诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
身份证号码	411424199303026613



续登注册
Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100320439
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d